

放熱材料「繊維状窒化アルミニウム単結晶」の 開発と展望について

近年、移動通信システムの高速度・大容量化が急速に進み、運用拡大する第5世代移動通信システム(5G)では、電子機器部品の高集積化や高速処理によって放熱性への要求が高まっています。高い熱伝導率と絶縁性を併せ持つ革新的材料「繊維状窒化アルミニウム単結晶(Thermalnite)」の開発動向及び今後の展望についてご講演いただきます。

《 日 時 》 令和3年11月18日(木) 14時00分~15時30分

《 開催方法 》 ZoomによるWebセミナー

《 内 容 》 放熱材料「繊維状窒化アルミニウム単結晶」の開発と展望について
講師 株式会社U-MAP 代表取締役 CEO 西谷 健治 氏

電子機器の高集積化や小型化に伴い、発熱によるパフォーマンスや機器寿命の低下などの問題が発生しています。「繊維状窒化アルミニウム単結晶(Thermalnite)」は、高い熱伝導性と優れた機械的特性を持ち、これらの問題解決に向けて、光通信分野や電気自動車などに用いられるパワーモジュール分野への展開が期待されています。

本セミナーでは、繊維状窒化アルミニウム単結晶(Thermalnite)の特徴や活用事例について解説していただきます。

《 定 員 》 50名(先着順)
参加申込みをいただいた方には、開催1週間前を目途に接続に必要なURL/パスワードをご案内します。
※定員を超えた場合のみ、その旨ご本人に連絡いたします。

《 参加費 》 無料

《 申込方法 》 当センターホームページからお申込みいただけます。
<https://www.kptc.jp/seminor/211118kagaku/>

《 申込先 》 京都府中小企業技術センター 基盤技術課 化学分析係
TEL 075-315-8633 E-mail kagaku@kptc.jp